

**产品应采用COB3in1 封装、全倒装工艺，R/G/B
晶片全部为倒装，所有晶片与 PCB 基板不使用任何材质的线材连接**

产品名称	产品应采用COB3in1 封装、全倒装工艺，R/G/B 晶片全部为倒装，所有晶片与 PCB 基板不使用任何材质的线材连接
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房 D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

- 1.像素间距： 0.9375mm；像素密度： 1137778 dots/m；采用压铸铝箱体，箱体比例满足 16:9 比例；
- 2.屏体尺寸：长 5400mm，高度 2700mm；
- 3.产品应采用 COB 3in1 封装、全倒装工艺，R/G/B 晶片全部为倒装，所有晶片与 PCB 基板不使用任何材质的线材连接；
- 4.产品应具备较好的对比度，zui高对比度应 12000：1（依据SJ/T 11281-2017《发光二极管（LED）显示屏测试方法》标准在环境照度为 10lx 下进行测试）；
- 5.产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应 98%（按T/SLDA 01-2020）；
- 6.产品应能展现丰富的色域，NTSC 色域覆盖率应 110% NTSC（按 T/SLDA 01-2020）；
- 7.产品 LED 模组表面防护等级应 IP65；
- 8.在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。
- 9.显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。
- 10.为保证显示屏系统的实用经济性，显示屏须具备低功耗模式，当开启此模式后，待机功耗可降低 13W 或以下11.显示单元具备 3C 认证证书；
- 12.投标人所投 LED 显示屏符合 CESI-PC-0D74 中 HDR3.0 显示的要求；

